

200X200Mm 가열 플레이트 및 수냉 시스템을 갖춘 15톤 자동 진공 핫 프레스

품목 번호: XP33



소개

KINTEK의 자동 15톤 진공 핫 프레스를 살펴보세요:
200x200mm 가열 플레이트(최대 500°C), 정밀 PID 제어, 수냉 시스템, 및 진공 또는 불활성 가스 처리용 SUS 304 챔버를 갖추고 있어 파우치 셀 배터리, 폴리머 라미네이션, 및 확산 접합에 완벽합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	핵심 이점
배터리 파우치 셀 라미네이션	리튬 이온 또는 전고체 배터리용 파우치 셀 라미네이션은 전해질을 손상시키지 않고 층을 접합하기 위해 균일한 압력과 열이 필요합니다. 진공 기능은 수분과 가스를 제거하여 층간 분리(delamination)를 방지하고 셀 수명을 연장합니다.	층간 분리를 방지하고, 이온 전도도를 개선하며, 사이클 수명을 연장합니다.
폴리머 필름 라미네이션	전자 부품 캡슐화, 의료 포장 또는 유연 디스플레이용 폴리머 시트나 복합 필름을 제어된 온도와 압력 하에서 라미네이션합니다.	정밀한 두께 제어로 기포가 없고 투명도가 높은 접합을 생성합니다.
확산 접합	용융 없이 고진공 하에서 고온으로 금속, 합금 또는 세라믹을 접합하여 원자 수준의 확산 결합을 생성합니다.	열 교환기 및 마이크로 유체 장치에 이상적인 기공이 없는 고강도 인터페이스를 달성합니다.
분말 성형 및 소결	진공 및 열 하에서 다이 내의 금속 또는 세라믹 분말을 압축하여 고밀도 펠릿이나 성형체를 형성합니다.	밀도를 높이고 기공률을 줄이며 기계적 및 전기적 특성을 향상시킵니다.
복합 소재 경화	불활성 분위기에서 정밀한 압력과 온도 프로파일로 첨단 섬유 강화 복합 소재를 경화시킵니다.	가고 최적화, 산화 방지 및 기포가 없는 라미네이트를 보장합니다.
유연 전자 부품 조립	진공 하에서 열 활성화 접착제를 사용하여 유연 회로, OLED 디스플레이 또는 박막 센서를 라미네이션하고 캡슐화합니다.	정렬을 유지하고 가스 발생 결합을 제거하며 민감한 부품을 보호합니다.

사양	값 / 세부 정보
모델	XP33
최대 작업 압력	≤ 15 톤 (150 kN)
플레이트 작업 온도	상온 - 500 °C, 프로그래밍 가능한 PID 터치스크린
가열 용량	3000 W
플레이트 치수	200 mm × 200 mm
플레이트 개구부 (Daylight)	50 mm
포함 진공 펌프	로터리 베인 진공 펌프 (표준)
진공 레벨 (상대압)	< -0.1 MPa
챔버 소재	SUS 304 스테인리스 스틸
분위기 가스 호환성	질소 (N ₂) / 아르곤 (Ar)

사양	값 / 세부 정보
냉각 방식	순환 수냉 (양쪽 플레이트)
외부 치수	650 × 492 × 725 mm
무게	235 kg
전원	AC 220V / 50Hz, 단상